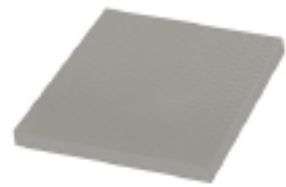


TP200-S 系列

导热硅胶垫片

TP200导热硅胶垫片是使用硅胶与导热陶瓷填料经由特殊工艺加工而成, 双面自粘, 低压缩力下表现出良好的导热性能和电气绝缘性能。在-40℃~150℃可以稳定工作, 满足UL94V0的阻燃等级要求。



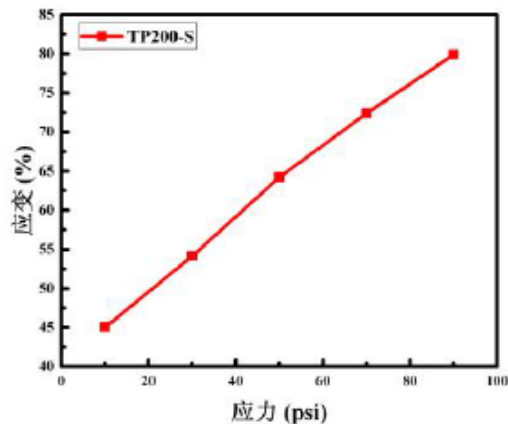
特性与优点

- 导热系数: 2.0 W/m.K
- 超软, 高度兼容
- 自然粘性, 易于使用
- 高电气绝缘
- 低压力应用, 具有高压缩比
- 良好的耐温性能

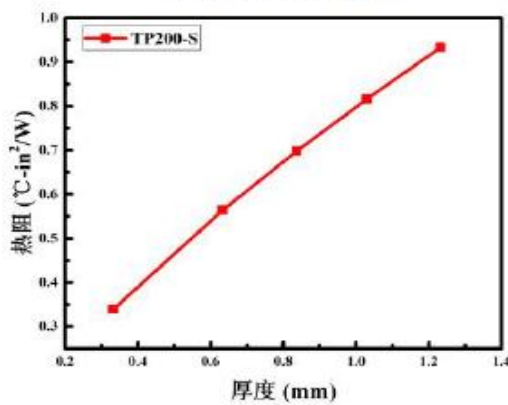
典型应用

- 网络和电信
- It: 笔记本电脑, 平板电脑, 电源转换器
- 工业: led, 电源和转换
- 汽车: 控制模块, 涡轮执行器
- 消费电子产品: 游戏系统和液晶显示器

形变量与压力关系图



厚度与热阻关系图



存储:

- 储存于阴凉、干燥、通风环境

保质期:

- 12个月。

典型属性		
属性	典型值	测试方法
	TP200-S	-
成分	有机硅+陶瓷	-
颜色	灰色	目视
厚度(mm)	1.0~12.0	ASTM D374
密度(g/cc)	2.82	ASTM D792
硬度(Shore OO)	25	ASTM D2240
耐温范围(°C)	-40~150	/
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥6.0	ASTM D149
体积电阻率 (Ω.cm)	10 ¹³	ASTM D257
介电常数	7.0	ASTM D150
防火性能	V-0	UL 94
导热性能		
导热系数(W/m-K)	2.0	ISO 22007-2